

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

中际旭创股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-008

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐业绩说明会 ☐现场参观 ☐分析师会议 ☐新闻发布会 ☒其他（电话会议） ☐媒体采访 ☐路演活动
-----------	---

	上海景林资管；上海水璞基金；盘京；上海聚鸣投资；虢盛私募；运舟私募基金；上海韞然投资；高毅资管；深圳乾图私募；深圳望正资管；财通证券资管；东方证券资管；招商证券资管；大家资管；平安养老保险；平安资管；上海人寿；太平养老；太平资管；泰康资管；新华资管；友邦人寿；阳光资管；中国人保资管；人民养老；平安人寿；中国平安；长江养老；伯恩斯坦；柏骏资管；邦德资管；Capital Group；大和资本；淡马锡；Goldman Sachs(Asia)L.L.C.；高盛资管(香港)；花旗；摩根大通公司；美银证券；麦格理资本；Point72HongKong；里昂证券；柏瑞投资香港；贝恩资本；工银资管(全球)；立格资本；T.Rowe Price；野村证券；工银理财；建信养老金；大和日华咨询；民生基金；前海中金资产；ASPEX；Jefferies；UG Investment
时间	2026 年 8 月 23 日（星期日）20:00—21:00
地点	/
上市公司接待人员姓名	公司副总裁、财务总监 王晓丽 公司副总裁、董事会秘书 王军
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司高管对 2026 年上半年的财务情况进行解读 2026 年上半年，收入利润各项指标同比都实现了较大增长。环比来看，利润率持续提升，保持了过去各季度的趋势。26Q2 收入相较 Q1 环比增长 15%左右，利润增幅更高。订单需求依然保持强劲，Q2 毛利率也有所提升，主要由于 1.6T 出货环比增长等因素。 费用端：二季度经营费用基本环比持平，部分费用环比有所下降，主要因 26Q1 有较多一次性费用，包括子公司层面费用及服务费结算等杂项费用，导致二季度部分费用环比下降，整体基本持平。财务费用有所增长，主要由于汇兑损失，公司有大量美元资产敞口形成汇兑损失，大部分为报表层面记账损失，并非实际损失。 利润率：26Q2 净利率环比提升约 3 个百分点，其中存在部分非经常性事项的影响，最大部分为投资供应链关键环节上市公司所产生的投

资收益，根据股价波动会产生公允价值变动损益，去除该部分后利润仍实现较好增长。

二、公司高管介绍 2026 年上半年整体经营情况

行业需求快速增长：回顾 2026 年上半年，全球 AI 大模型训练和推理对算力快速增长的需求，直接拉动了对高速光模块的需求，带动了 800G 和 1.6T 等高端光模块的持续放量。公司充分发挥技术、产能、供应链各方面优势，积极交付 1.6T 和 800G 等高端产品，上半年收入同比增长非常明显，并继续保持季度环比增长的良好状态。

公司保持良好交付能力：上游物料下游需求快速增长的同时，上半年光芯片、电芯片、PCB 等核心物料供应仍比较紧张。公司通过提前预判，采用长协、预付款、导入新供应商等方式锁定上游产能，保证供应能力仍处在行业较高水平，保持了良好的交付能力。

订单需求饱满的背后原因：主要是云厂商对基础设施的大力投入，部分客户上调了 26 年甚至 27 年的资本开支指引，同时算力芯片的配置规格进一步升级，光互连产品作为 AI 集群网络的核心环节，重要性日益凸显。随着 AI 网络规模扩大，xPU 对应的光模块比例进一步上升。

未来展望：目前主要客户已给出 2027 年的指引和订单，2027 年 1.6T 和 800G 的订单需求相较 2026 年仍保持快速增长。新产品如 2.4T、NPO、XPO 等将适用于 scale-out、scale-up 等应用场景。根据大客户定制要求，公司正在积极开发或送样，新产品有望于 27 年下半年量产，28 年有望实现更大规模出货。公司也在积极建设新产能，做好光芯片、电芯片、PCB 等核心物料的准备，为 27 年更大规模上量做好准备。

三、投资者问答环节

Q1：公司的毛利率和净利率持续向好，后续的利润率趋势？未来物料逐步缓解后，毛利率是否会有进一步改善？

A1：目前毛利率处于不错水平，未来公司将努力维持毛利率稳

	定，内部目标是希望实现毛利率的适当增长。从行业来看，有正向因素也有负向因素。正向因素为公司 1.6T 市占率较高，客户出货量有望继续增长，硅光渗透率也有望进一步提升，均为提升毛利率的有利因素；负向因素是部分上游物料存在涨价压力，部分会传导至公司，但公司也会与客户协商转嫁一部分成本压力。公司的目标是保持毛利率在较高水平并希望实现小幅增长，大幅提升不符合行业特点。 2027 年 2.4T、NPO、XPO 等新产品有望逐步上量，这些产品具有高带宽、定制化的特点，毛利率有望优于现有产品，公司整体毛利率有望迎来更大的提升空间。公司的毛利率提升一方面靠 BOM 成本和良率的改善，另一方面更重要的是靠新产品对整体产品结构的改善和毛利率的拉动，有望在 2027 年看到相应变化。 Q2：二季度应收账款增长较为明显，账期也有所增长，背后的原因？ A2： 若按季度余额计算，可能看到应收账款二季度比一季度更高，但实际上每个客户的账期和收款节奏均未变化，这与出货时间点相关。6 月当月有较多出货，余额并非平均分布，月末较高，因此计算周转天数会较高。 Q3：请教 NPO 的情况，公司明年的需求和研发进展？ A3： 预计 NPO 将成为行业客户普遍接受的光互连方案，主要用于 scale-up 场景，具有易维护、低成本、稳定性和可靠性强等方面的优势，且能充分发挥光模块的成熟工艺优势。现阶段很多客户在积极交流 NPO 方案，部分客户已给到明确需求指引和订单，2027 年有望实现出货，预计更多客户会在 2028 年上 NPO。公司正在与客户积极沟通，并根据客户要求定制化开发。随着带宽的不断提升，NPO 有望成为 scale-up 的光互连解决方案之一。 Q4：近期大家担心上游物料的涨价，是否会对公司的成本造成压力？
--	---

A4: 物料供给目前比较紧张，主要由于下游需求增长太快，上游扩产速度偏慢。部分物料确实出现涨价，但公司供应量较大的产品涨价幅度并不大，主要是因为公司已锁定较强合约，订单量也较大，拿到的价格较有优势。在后续客户交付上，公司的产品价格降幅相对理性，并非市场传言的剧烈下降。整体而言，公司通过技术手段（包括硅光比例和良率提升）、27 年新产品放量等方式，均有利于把控成本，进一步提高整体毛利率水平。

Q5: 明年 1.6T 的 DSP、光芯片、PCB 的供应紧缺程度如何？预计何时能够缓解？

A5: 以上物料供应确实偏紧张，预计今年供应紧张的情况将继续显现，改善并非易事，但有望逐季度好转。PCB、光芯片等物料的供应商也在积极扩产，预计今年下半年到明年上半年供应商的产能将逐步释放，整体供给有望逐步改善。

Q6: 1.6T 的 DSP 供应紧张是否有加剧？

A6: 核心是 3nm DSP 的产能供应偏紧张一些，整体还好，仍能保持供应。大客户对重要物料的分配有较强的主导权，公司在大客户方面占有较高份额，并保持较好交付能力，预计公司仍能拿到足够的物料供给。

Q7: 二季度管理费用率和研发费用率有所下降，全年的费用率展望？

A7: 二季度研发和管理费用环比略有下降，主要由于一季度子公司及服务费结算等一次性费用的扰动。研发费用率下降的主要原因是收入基数增长较快。公司内部有很多研发项目在持续推进，季度间物料领用、项目进展等影响也会逐步显现。未来希望研发费用绝对额持续增长，研发费用率受规模效应因素影响，希望保持在比较健康的水平。

Q8: 二季度经营性现金流下降的原因？

A8: 目前下游需求非常旺盛，在满足客户交付的同时，公司也在

积极备产备料。26年上半年经营性现金流支出绝大部分为购买原材料，其中部分是满足现实交货节奏的正常采购，此外还有大量提前备货。与备料相关的科目有预付账款和其他长期资产。其他长期资产主要体现了锁定一年以上的预付款，二季度环比增长 10 亿元以上。

Q9：二季度资本开支增长的原因？

A9：资本开支包括设备和厂房的投入，公司多处厂房都在扩建中，小部分预计在 26 年下半年交付，大部分预计在 27 年交付。

Q10：资本开支未来一到两个季度是否可以转化为收入？

A10：基建支出投入周期较长，大部分会在 27 年开始转化为收入。整体来看，未来收入有望实现逐季度增长。

Q11：1.6T 方面新进入者扩张速度较快，是否会对公司产生竞争压力？

A11：1.6T 需求已成为 AI 数据中心普遍应用的方案，下游客户包括 CSP、设备厂商、芯片厂商、新云及大模型公司，客户结构更加多元化，需求增长非常迅猛。2027 年全球行业需求增长迅速，因此会有新的友商进入并拿到一定份额。但公司现有 CSP 客户的份额依然保持稳定，并未看到更多新进入者；新云客户可能会看到更多新进入者。CSP 客户仍然将主要的 1.6T 份额分配给固有供应商，整体竞争格局并未发生较大变化。

Q12：NPO 方面的研发进展如何？

A12：公司在开发阶段处于领先地位，与大部分 CSP 客户及芯片厂商都有沟通，目前公司有不同的技术方案在定制化开发，并向客户积极送样。预计 2027 年公司有望成为第一批交付 NPO 的供应商。由于 NPO 产品为高度定制化，客户不会开放太多机会，因此能够率先进入定制开发领域的供应商，有望取得较好的竞争优势。

Q13：一二季度汇兑损失如何，套期保值的效果如何？

A13: 二季度汇兑损失约 4 亿元，一季度约 3 亿元。目前套期保值的远期产品较少，美元利率较高，远期锁汇成本较高。公司会采取多种措施，包括针对资本开支和结汇需求做套期保值等，保护实际结汇的部分，因此真正实现的汇兑损益一直控制的较好。二季度汇兑损益包含关联交易产生的汇兑损益，主要是由于会计准则产生的，并非真实实现的汇兑损益。未来公司一方面会尽量减少子公司之间的关联挂账，消除会计影响；另一方面也会关注更多远期对冲方式，寻找更经济有效的产品。

Q14: 客户是否有签订光模块的长协？

A14: 过去光模块行业通常签订 3 个月订单，目前很多客户已给到 27 年订单，相较过去已有较大提升。也有部分客户正在与公司洽谈长协，具体细节不便披露。

Q15: 二季度存货增加 40 多亿、预付款环比下降，是否可以理解为保障物料？

A15: 公司的预付款仅针对关键品类的关键供应商，并非所有物料都进行预付，长期资产下的长期预付款更是对长期物料的安排。目前物料仍偏紧张，但三季度预计会有环比改善。公司采取了积极的供应链措施，包括预付、锁料、长协等；另一方面公司客户份额相对确定且规模较大，在供应商的份额分配中具备相对优势，物料供应有相应保障。

Q16: 公司未来新的技术工艺方面的储备如何，包括 coherent lite、薄膜铌酸锂等？

A16: 公司新产品包含多种新技术，均有多年技术沉淀，有些甚至长达 10 年以上。公司有自信将这些技术应用于新产品，能根据客户定制化要求进行开发，整体技术壁垒较高，与之前的传统光模块相比有较大区别，尤其是硅光、相干和薄膜铌酸锂等技术应用于新产品，预计未来的技术曲线将越发陡峭。

Q17: 二季度资本开支较高，后面几个季度的扩产力度？

A17: 今年整体来说扩产力度都比较大，下半年的资本支出也会比较高，这也是由于订单能见度很高，需求非常旺盛。公司今年做的港股发行，也是预见到了未来下游客户的需求还是非常强劲的，所以需要进行资本开支的强力投入，所以 7 月港股发行融了 70 亿美金，会对扩产、备料形成有效的支撑，且后续融资更加便捷，对业务的增长也是较好的依托。预计下半年资本开支还会有增幅，基建方面会有增长，设备一般是前三季度完成。预计今年下半年到明年资本开支都会比较大。

Q18: 公司在硅光有很强的竞争优势，未来新产品中硅光等新技术的应用情况和预期渗透率如何？

A18: 硅光技术在下一代技术中仍将发挥关键作用，包括 2.4T、3.2T、NPO、XPO 及未来更先进产品。除了硅光，也会搭配更多新技术，包括薄膜铌酸锂、coherent lite，以及电芯片、光芯片的混合集成等。未来光互连产品将面临越来越高的技术壁垒，且是技术的综合使用，而非单一方案。公司在这方面有技术先发优势，也会在这些产品上积极采用这些技术，力争取得较好的效果。

Q19: CPO 的需求和落地节奏？公司的参与程度，和 NPO 的差异化？

A19: CPO 目前看到客户已宣布量产，主要应用在 scale-out，未来将逐步应用在 scale-up。Scale-up 方面，NPO 也将是客户普遍接受的方案，柜间互联和其他应用场景都会看到。此外，可插拔也将出现在 scale-up 和 scale-out，包括 2.4T、3.2T 及 XPO 产品。未来的光连接技术形态不会是单一化方案，而是多元化解决方案，包括可插拔、NPO、CPO 等。公司有能力参与到多种技术形态的解决方案中去。

Q20: 关于资本开支，国内和海外的产能分配？2.4T 及未来新产品是否能满足海外出货的要求？

A20: 新产品更多产能将放在海外，如 coherent lite、NPO 等。目前已发生的资本开支包括境内和境外。随着新产品推进，未来海外比重

	可能会有所提升。 四、会议结束。
	交流过程中，公司参会人员严格遵守有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。以上会议纪要内容不代表公司的盈利预测和业绩指引，请投资者注意投资风险并谨慎投资。
日期	2026 年 8 月 23 日